

歷史及公司架構

概覽

我們的業務歷史可追溯至1995年，彼時AMTEK（即Amlogic Inc.（「**Amlogic CA**」）的前身）於加利福尼亞州註冊成立，其後於2000年8月更名為Amlogic CA，由John Zhong先生擔任董事長。本公司由John Zhong先生於2003年7月11日根據中國法律創立，旨在拓展中國業務。於2006年4月，Amlogic Inc.（「**Amlogic DE**」）於特拉華州成立。於2011年11月，Amlogic DE與Amlogic CA合併，其後於2014年1月，Amlogic DE被Amlogic Holdings Ltd收購。在過去數十年間，隨著本集團的重組，本公司離岸控股股東先後為Amlogic CA、Amlogic DE及Amlogic Holdings Ltd。

經過數年，我們已發展成為領先的系統級半導體設計廠商。我們為智能家居、智能辦公、智能出行、娛樂與教育及工業生產等多種應用場景，提供先進的智能終端控制與連接解決方案。我們的產品組合主要包括智能多媒體及顯示SoC、AIoT SoC、通信與連接芯片及智能汽車SoC。我們致力於賦能全球智能設備從基礎連接走向智能無縫互聯。

本公司於2003年7月11日根據中國法律成立。於2019年8月，我們的A股在上海證券交易所科創板上市（股份代號：688099）。截至最後實際可行日期，我們的已發行股本總額為人民幣421,165,613元，包括421,165,613股A股。

重大的企業及業務發展里程碑

下表載列我們各項重大的企業及業務發展里程碑。

年份	事件
1995年	• Amlogic CA的前身註冊成立。
2000年	• John Zhong先生獲委任為Amlogic CA的董事長，並牽頭重組其核心管理團隊。
2003年	• 本公司成立。
2004年	• 我們開發出全球第一片整合RMVB技術於視頻解碼器的SoC。
2005年	• 我們於全球率先推出數字電視多媒體應用處理器解決方案。

歷史及公司架構

年份	事件
2006年	• 我們與領先的半導體代工廠合作，以130納米制程芯片進行量產。
2007年	• 我們將單芯片解決方案引入數碼相框產品，成功贏得市場領先地位。
2008年	• 我們與領先的半導體代工廠合作，以90納米制程芯片進行量產。
2009年	• 在消費性電子產品線中，我們與全球領先的半導體設計商和服務供應商合作，成功掌握技術變革的方向。
2010年	• 我們開發了全球第一款1080P全高清解碼器，採用基於Cortex-A9 CPU和Mali-400 GPU的Android操作系統。
2011年	• 我們於全球率先推出基於Android 4.0的智能電視、平板電腦和IP機頂盒SoC芯片。
2012年	• 我們為全球領先科技公司電視產品的首批戰略合作夥伴，並發佈了雙核Cortex-A9芯片系統，隨後成功應用於平板電腦、機頂盒和數字電視等消費電子產品。
2013年	• 我們成功實現了28納米四核A9 CPU SoC的量產，並在智能機頂盒SoC的出貨量方面領先業界。
2014年	• 我們發佈旗艦四核應用處理器，具備4K2K H.265解碼器和超低功耗。
2015年	• 我們發佈64位多核4K2K OTT和機頂盒單芯片系統。
2016年	• 我們推出Google Cast Ready WiFi音訊單芯片系統，以及64位多核4K2K VP9 SoC。
2017年	• 我們為揚聲器和條形音箱(Soundbar)推出語音控制技術，並推出全球電視單芯片系統。
2018年	• 我們推出12納米UHD TV/STB SoC，以及Smart Vision SoC。
2019年	• 我們開發了智能電視SoC和4K Smart Vision SoC。

歷史及公司架構

年份	事件
2020年	• 我們開發了AV1 STB、TV芯片及Wi-Fi 5無線連線芯片。
2021年	• 我們推出MEMC/AI-SR全球DTV SoC，並將前置式IVI車載娛樂SoC投入量產。
2022年	• 我們推出Wi-Fi 6和Bluetooth 5芯片，以及8K STB SoC。
2023年	• 我們推出了首款支持4K144Hz超高清全格式的智能電視處理器芯片。
2024年	• 我們為Matter推出6納米UHD STB SoC三頻連接芯片。
2025年	• 我們推出4G LTE Cat1芯片。 • 我們推出一款高端智能電視之旗艦SoC，支持4K 165Hz高刷新率、強大AI算力及全格式8K解碼功能。
2026年	• 我們推出一款電競級顯示器SoC，適用於遊戲、辦公、專業設計顯示器及商業顯示設備。

主要子公司及經營實體

下表載列我們主要子公司（對我們的經營業績有重大貢獻）於往績記錄期間關鍵信息的概述。

子公司名稱	註冊資本	本集團 應佔股權	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立日期	主要業務活動
Amlogic Shenzhen	人民幣 61,132,000元	100%	中國	2014年6月25日	IC芯片產品的 研發和銷售
Amlogic HK	9,000,000 美元	100%	香港	2015年9月23日	銷售及分銷 芯片

歷史及公司架構

截至最後實際可行日期，我們擁有16家子公司。有關該等子公司的進一步詳情，請參閱本節「— 公司架構」。有關我們子公司註冊資本的變動，請參閱本文件「附錄七— 法定及一般資料— (A)有關本集團的進一步資料— 3子公司股本變動」。

本公司的重大變動

成立本公司及改制為股份公司

本公司，當時稱為晶晨半導體（上海）有限公司，成立於2003年7月，初始股本為1,000,000美元。於2017年3月，本公司改制為股份公司。於改制完成後，本公司的股本總額為人民幣370,000,000元，分為370,000,000股股份，本公司由單一最大股東集團成員Amlogic (Hong Kong) Limited控制，持股52.43%，以及獨立第三股東TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.（「TCL」），持有本公司當時11.29%的股權，其餘其他股東各自持有本公司不到10%的股權。

於上海證券交易所科創板上市

於2019年8月，本公司在上海證券交易所科創板上市，股票代碼為688099。在科創板上市過程當中，本公司完成首次公開發售A股（「A股發售」），據此，本公司的股本總額由人民幣370,000,000元增加至人民幣411,120,000元。緊隨A股發售後，本公司由Amlogic (Hong Kong) Limited控制35.56%股權，TCL持有本公司當時10.16%股權，其餘股東各持有本公司當時少於10%股權。

截至最後實際可行日期，本公司股本總額為人民幣421,165,613元，均分為421,165,613股A股（包括本公司回購作為庫存股持有的1,334,489股A股），由Amlogic (Hong Kong) Limited持有18.86%的股權，其餘股東各持有本公司5%以下的股權。我們股本總額及股東持股比例的變動主要是由於我們根據受限制股份計劃增發股份以及Amlogic (Hong Kong) Limited出售若干股份所致。

重大收購及出售

於往績記錄期間，我們並無進行任何我們認為對我們而言屬重大的收購、出售或合併。

歷史及公司架構

我們於上海證券交易所上市的情況及於聯交所上市的理由

本公司自2019年8月起在上海證券交易所科創板上市。我們尋求在香港聯交所上市，以進一步提升本公司的資本實力及綜合競爭力，並推進本公司國際化戰略。詳情請參閱「業務－戰略」及「未來計劃及所得款項用途」。

我們的董事已確認，自我們於上海證券交易所科創板上市起及截至最後實際可行日期，我們概無發生嚴重違反上海證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規的情形，且據我們的董事經作出一切合理查詢後所深知，並無與我們於上海證券交易所的合規記錄有關的重大事項須提請投資者垂注。中國法律顧問認為，我們並無面臨中國證券監管機構施加的任何重大行政處罰或監管措施，且我們已於所有重大方面遵守上海證券交易所的相關規則及適用於我們的中國其他適用證券法律法規。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查，聯席保薦人並未注意到任何事項將導致其不同意董事就本公司於上海證券交易所的合規記錄作出的確認。

[編纂]

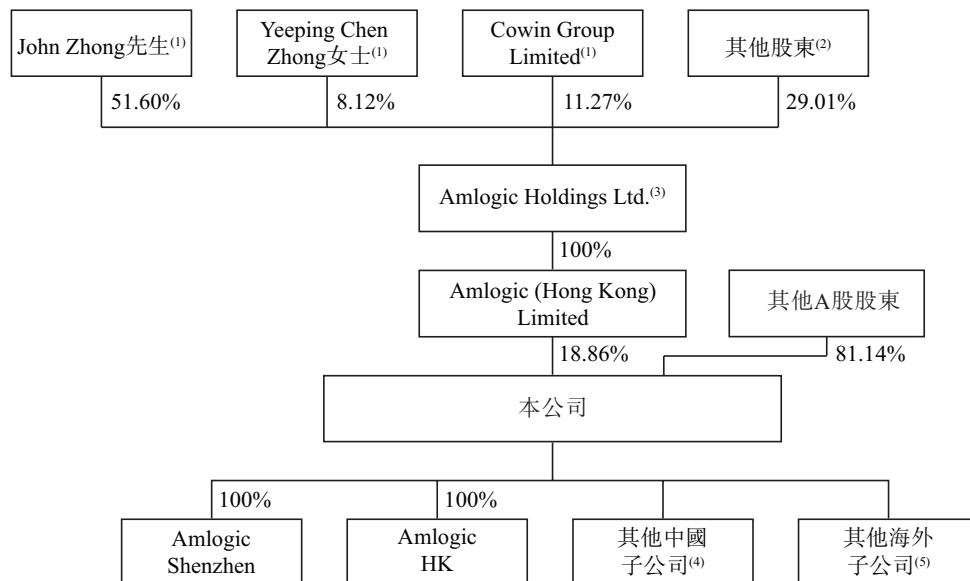
歷史及公司架構

[編纂]

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

以下簡圖說明本集團緊接[編纂]完成前的公司及股權架構（假設自最後實際可行日期起直至上市本公司的已發行股本總額並無任何變動）：



附註：

- (1) Cowin Group Limited由陳海濤先生（Yeeping Chen Zhong女士的父親）全資擁有。根據中國法律及法規，John Zhong先生、Yeeping Chen Zhong女士（John Zhong先生的配偶）及陳海濤先生均被視為一致行動人士，故被視為於彼此所持有的股份中擁有權益。詳情請參閱「主要股東」。
- (2) Amlogic Holdings Ltd.的其他股東包括(i)Michael Yip（我們的原副總經理，已於2025年5月辭職，且為獨立第三方），持有Amlogic Holdings Ltd.6.33%的股份；(ii)Proland Group Ltd.，持有Amlogic Holdings Ltd.6.31%的股份，並最終由Cheung Kin（為獨立第三方）持有100%股權。據本公司所知，Proland Group Ltd.主要從事計算機編程服務；(iii)Century First Ltd.，持有Amlogic Holdings Ltd.2.03%的股份，並最終由Vincent Tai（為獨立第三方）持有100%股權。據本公司所知，Century First Ltd主要從事黏土製品及耐火材料製造；(iv)Raymond Wing-Man Wong（Amlogic Shenzhen的

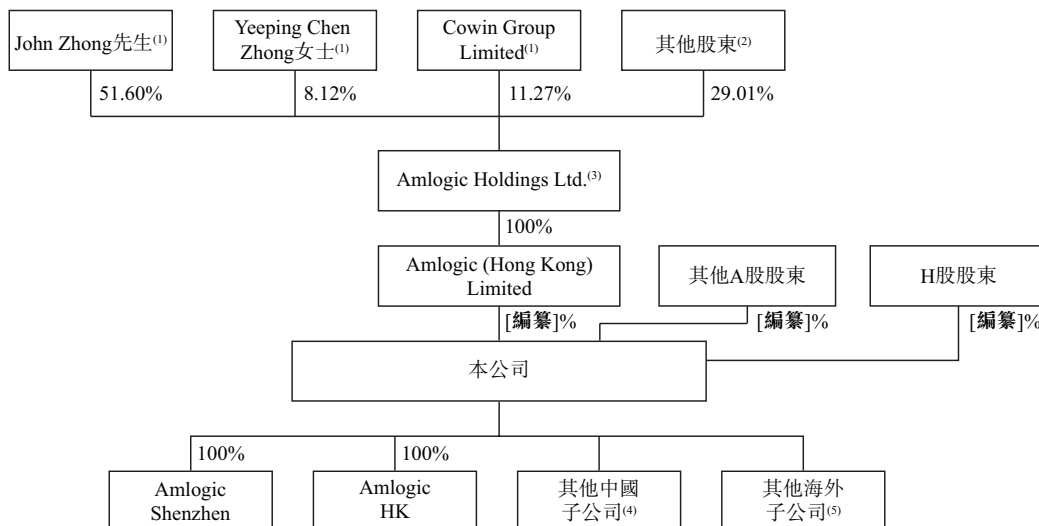
歷史及公司架構

監事)，持有Amlogic Holdings Ltd. 1.49%的股權；及(v)Amlogic Holdings Ltd. 其他分別持股少於2%的股東，均為獨立第三方。據本公司所知，該等股東概無持有Amlogic Holdings Ltd. 10%以上的股權，且與John Zhong先生、Yeeping Chen Zhong女士及／或陳海濤先生並無任何一致行動關係。

- (3) Amlogic Holdings Ltd. 的已發行股份總額為12,074,236股，其中，299,417股由Amlogic Holdings Ltd. 持有作為庫存股。
- (4) 本公司的其他中國子公司包括(i)晶晨半導體科技(北京)有限公司、晶晨半導體(西安)有限公司、晶晨芯半導體(成都)有限公司、晶晨半導體(南京)有限公司、合肥晶晨芯半導體有限公司、晶晨半導體(上海)有限公司、晶晨半導體(上海)有限公司及晶晨半導體(珠海)有限公司，均由本公司全資擁有；(ii)上海晶旻企業管理中心(有限合夥)，由本公司作為有限合夥人擁有95%權益，由Amlogic Shenzhen作為管理合夥人擁有5%權益；及(iii)上海晶毅商務諮詢合夥企業(有限合夥)，由本公司作為有限合夥人擁有65.70%權益，由上海鼎源國際貿易有限公司作為有限合夥人擁有33.30%權益，由Amlogic Shenzhen作為管理合夥人擁有1%權益。上海鼎源國際貿易有限公司主要從事國際貿易及貿易諮詢服務。其由文洋有限公司持有100%股權，而文洋有限公司繼而由Ting Ka Yee及Ting Yat Ming(均為獨立第三方)分別持有66.60%及33.40%股權。
- (5) 本公司的其他海外子公司包括(i)Amlogic (CA) Co., Inc.；(ii)Amlogic Singapore Private Limited；(iii)Amlogic Korea Limited；(iv)Amlogic Co., Limited(全部均由本公司直接或間接全資擁有)；及(v)Archer Vision Limited(由Amlogic Co., Limited及獨立第三方ARCHER ALLIANCE LIMITED分別擁有99.8351%及0.1649%)。

緊隨[編纂]後的公司架構

以下簡圖說明本集團緊隨[編纂]完成後的公司及股權架構(假設[編纂]未獲行使及自最後實際可行日期起直至上市本公司的已發行股本總額並無任何變動)：



附註1至5：請參閱上文「公司架構－緊接[編纂]前的公司架構」分節所載的詳細資料。